

INNOVATION TOGETHER

EQUIPMENT

電子生產製造設備展

Electronic Equipment Exhibition

DISPLAY

智慧顯示展

Smart Display Show

SMART⁺

智慧製造展

Smart Manufacturing Taiwan

展後報告 2026

POST SHOW REPORT



「光進銅退」時代來臨

2026 聚焦矽光子與先進封裝新商機



智慧顯示展








DISPLAY

-  電子紙
-  Micro & Mini LED
-  智慧座艙
-  工業材料
-  新創學研
-  淨零碳排



電子生產製造設備展

EQUIPMENT

-  PLP面板級封裝設備/材料
-  矽光子技術與設備
-  半導體封裝與組裝設備
-  半導體智慧化解決方案
-  先進封裝測試
-  化合物半導體材料/設備
-  電子設備關鍵模組/零組件



智慧製造展

SMART+

-  AI人工智慧與物聯網
-  數位轉型與系統整合
-  智慧工廠與企業戰情
-  供應鏈資安
-  產業AI應用
-  智慧機器人與移動載具

2026 展覽規模

全球匯聚 × 產業聯結 × 共創無限商機



300+

廠商

完整產業鏈展示
商機一次到位



820+

攤位

多元產品與服務
全面展出



200+

海內外講者

趨勢 × 技術 × 應用
引領產業未來



29,171+

海內外專業人士

匯聚全球產業決策關鍵人



12+

參展國別

國際參與度
持續擴大



49+

海外專業
人士國別

跨國交流合作
拓展全球市場



4445+

國際論壇

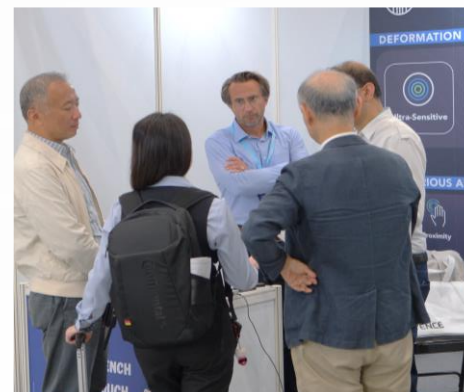
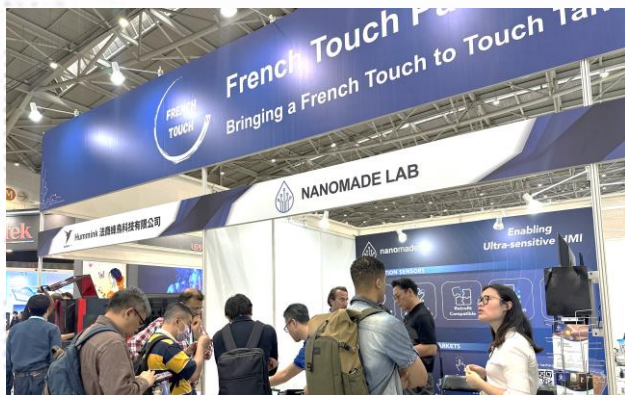
深度交流 × 思維碰撞
掌握產業新趨勢

30場



鏈結49國海外買主 布局全球市場

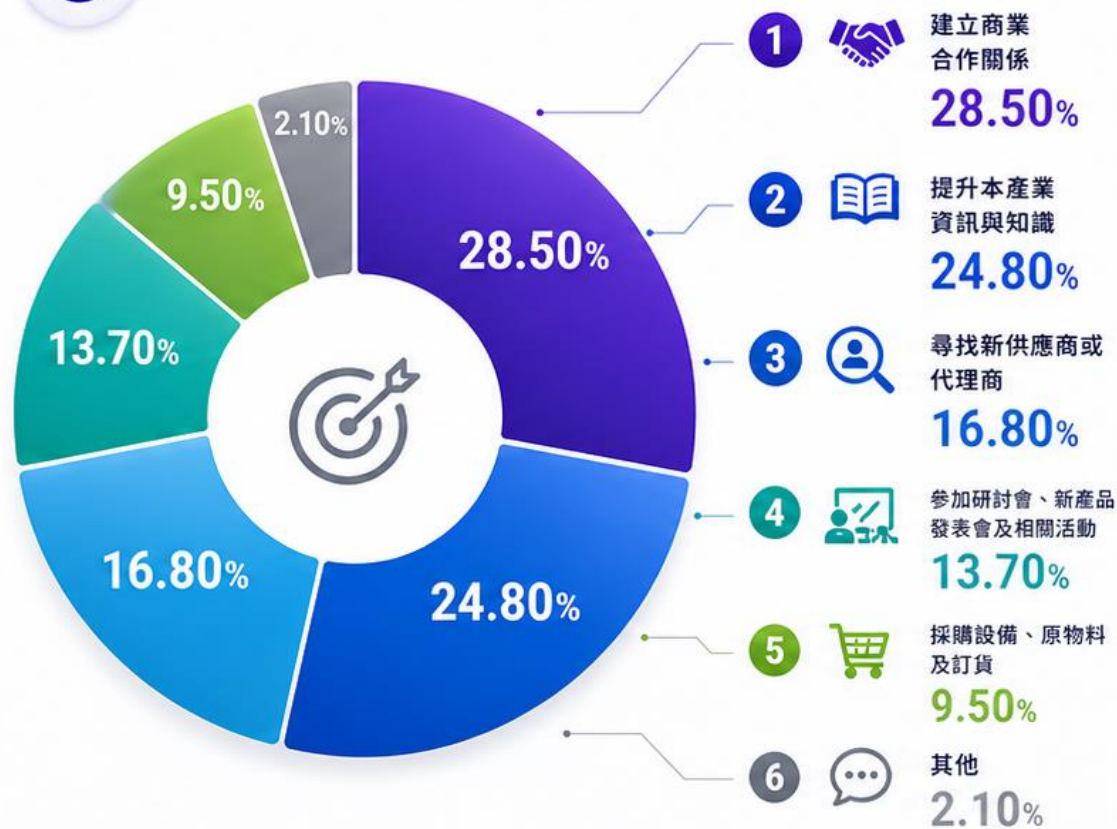
本次展會吸引「法國」與「泰國」國家館來台參展，展現各國在先進封裝、顯示應用、AR、VR相關技術的發展成果，同時也反映國際廠商來台布局動能持續提升，透過展覽與論壇交流，進一步促進台灣與東南亞及歐洲之間的技术合作與投資連結，強化區域產業鏈整合。



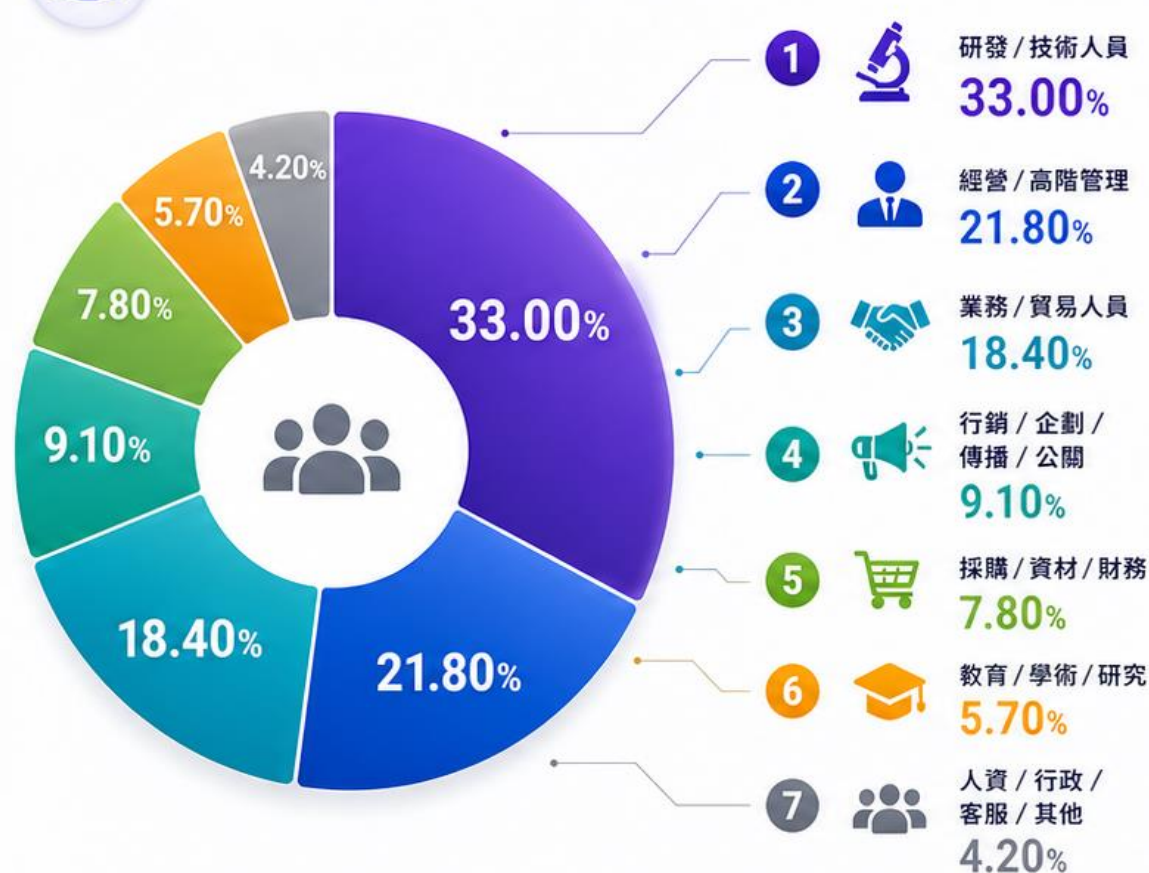
參觀者目的/職位



參觀目的分析 (單位：%)



參觀者職務分析 (單位：%)



參觀者從事業別

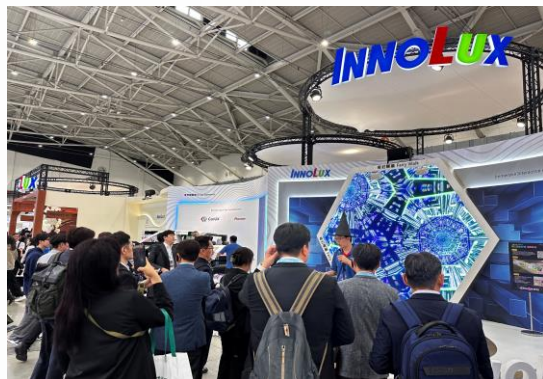
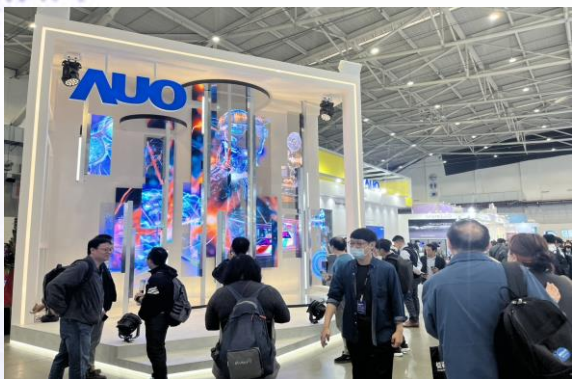


- 1
27.80%
顯示器 / 面板 / OLED
顯示技術核心產業
- 2
15.80%
半導體 / IC設計 / 封裝測試
推動晶片創新與先進製程
- 3
14.30%
電子設備暨零組件
關鍵設備與零組件供應
- 4
12.10%
智慧製造與AI人工智慧
AI賦能製造與智慧決策
- 5
9.80%
工廠生產自動化
自動化升級提高生產力

• Micro LED 到矽光子封裝 全球電子紙供應鏈 •

從 MICRO LED 量產到矽光子封裝，驅動次世代智慧顯示生態系

以「AI 賦能」為核心引擎，成功鏈結 Micro LED、扇外型面板級封裝 (FOPLP) 與矽光子 (Silicon Photonics) 等戰略性關鍵技術，深刻體現台灣顯示產業已跳脫傳統面板供應商範疇，在半導體先進封裝與跨領域系統整合中，成功建構起不可或缺的全球競爭實力。



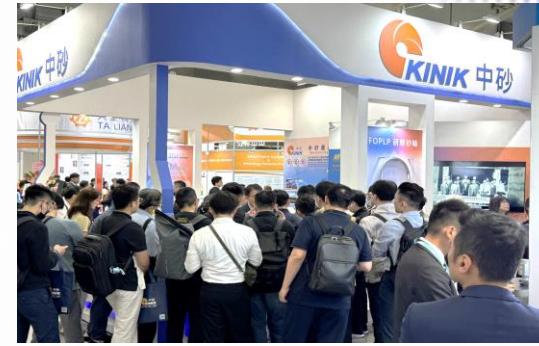
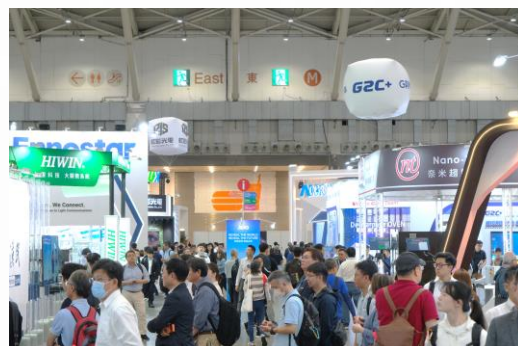
全球電子紙上下游產業夥伴，打造智慧城市 x 永續顯示應用

匯集全球20多家電子紙上中下游供應鏈夥伴共同展出，包括全彩膽固醇液晶顯示技術領導廠商虹彩光電也擴大展示最新全彩電子紙技術與多元應用，呈現電子紙在智慧城市、智慧零售與永續顯示應用上的創新發展，展現台灣電子紙產業的技術能量。



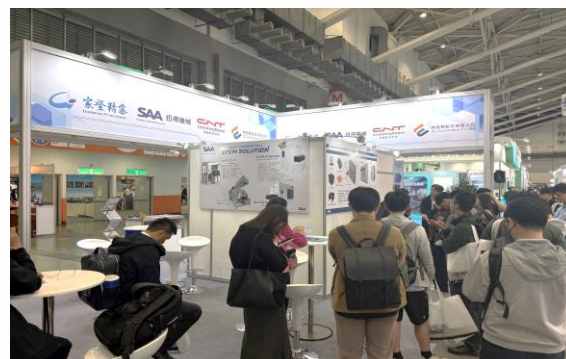
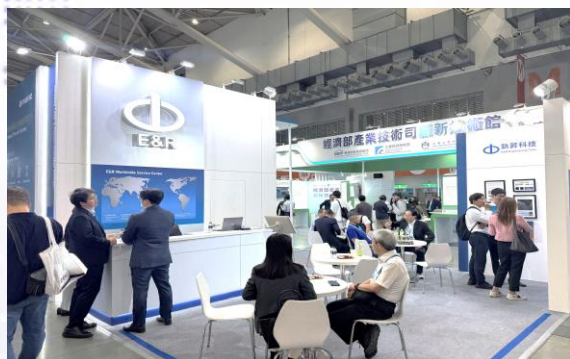
光進銅退，跨越CPO開啟高速運算新紀元

電子設備展全新導入 CPO 矽光子主題，呼應AI與高速運算帶動的「光進銅退」趨勢，從關鍵材料、設備製程到終端應用全面串聯，打造跨域整合的封裝產業生態系，展現次世代高速光通訊與AI應用的關鍵布局，反映全球半導體與光通訊產業的技術演進方向，更突顯台灣在先進封裝與光電整合領域的關鍵地位，成為觀察未來產業趨勢的重要指標平台。



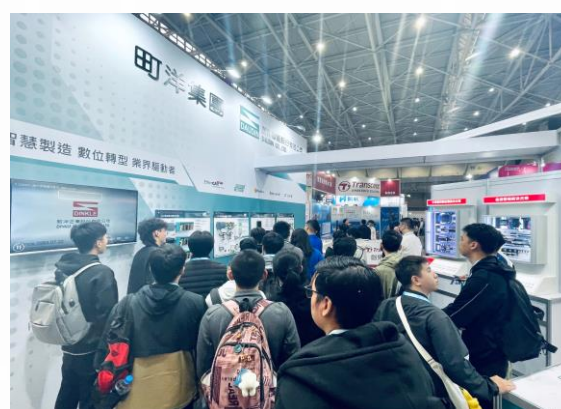
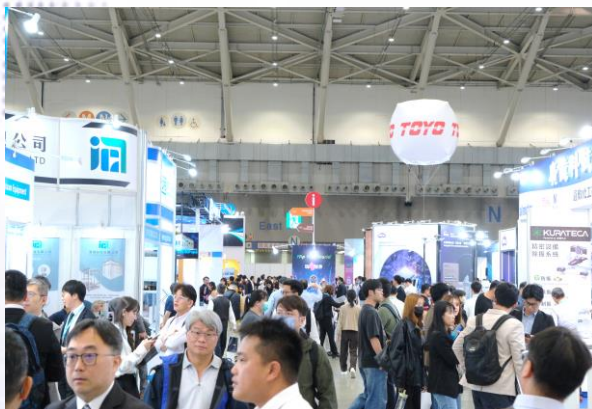
PLP面板級封裝專區 | 產業領導廠商匯聚

本次PLP面板級封裝專區共吸引**41家**廠商、**135個**攤位參展，從上游材料、TGV與玻璃基板技術，到中段RDL與製程設備，再到後段檢測與封裝整合，完整呈現PLP產業鏈布局，參展商包含鈦昇、由田、亞智、帆宣、志聖、均豪、均華、東捷、大量、迅得、群翊、致茂、海德漢、翔緯光電等指標業者，同時搭配展期間論壇活動，深化技術交流與產業對話，進一步促進合作契機與商機媒合，提升整體展出效益。



AI人工智慧賦能供應鏈 加速跨域製造商機

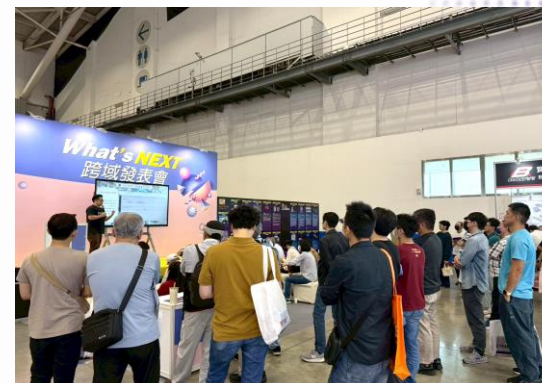
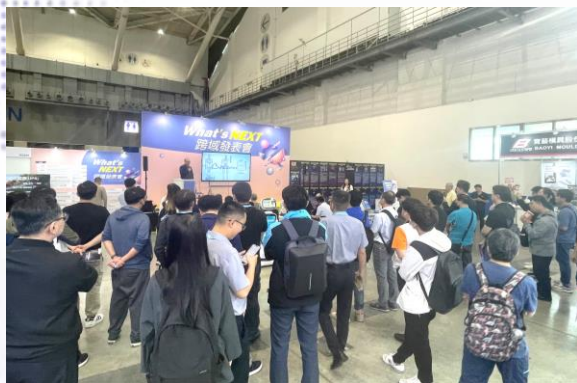
聚焦機器人應用、智慧製造、自動化系統與數位轉型等核心領域，涵蓋多元創新技術、實務應用、整體解決方案及互動式體驗服務，促進技術交流與落地應用。匯聚東佑達、放伴智能、台達、工智聯及鼎華智能等國內指標廠商參與展出，打造高效交流與媒合展示平台，加速機器人與智慧製造技術導入各產業場域，進一步帶動台灣產業數位轉型與升級，提升整體國際競爭力。



What's Next 跨域發表會

聚焦智慧製造、AI、電子設備與顯示跨域應用

期間共辦理21場次活動，聚焦AI視覺辨識、製造流程優化、電子設備自動化、高效能顯示模組及物聯網應用等關鍵領域，系統性整合多元創新成果。透過深度對談、技術發表與實機展示，成功串聯產業鏈上下游關鍵節點，加速技術驗證與應用落地，並有效促進跨域整合與合作媒合。整體推動不僅擴大產業參與深度與廣度，更持續累積創新能量，強化產業競爭優勢，為我國產業數位轉型與高值化發展注入具體且可持續之成長動能。



聚焦AI與先進製程 開創跨域合作新局



開幕典禮



科技領袖交流晚宴



團體導覽



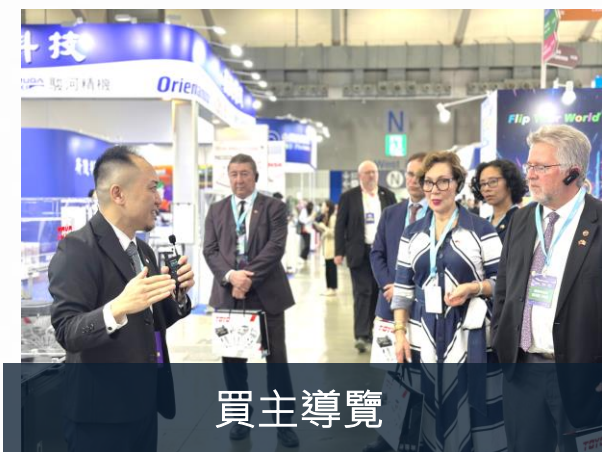
海內外公協會參訪交流



貴賓巡禮



跨域發表會



買主導覽



TDUA理事長盃高球菁英邀請賽

攜手廠商打造低碳低汙染的綠色展會

呼應全球淨零排放與永續發展趨勢，持續深化綠色會展推動，攜手參展廠商全面實踐環境責任與ESG核心理念。持續推動「3R」原則「減少使用、重複利用、可回收」為核心策略，從展場規劃設計、材料選用到施工管理進行全流程優化，有效降低裝潢廢棄物與碳排放。感謝今年參展企業展現了兼具設計感與環保責任的展示空間，經過嚴格評選，恭喜以下企業脫穎而出：



鑽質獎

友達光電股份有限公司
明基材料股份有限公司
漢民科技股份有限公司



金質獎

均豪、均華、志聖、東捷
默克先進科技材料股份有限公司
晶彩科技股份有限公司



銀質獎

樂榮貿易股份有限公司
大量科技股份有限公司
創為精密材料股份有限公司



專業獎項加值 展產業創新實力

前瞻技術與跨域應用最具指標性的榮耀舞台



顯示器元件產品技術獎

獎項	得獎廠商	得獎者 / 得獎作品	
傑出人士貢獻獎	友達光電股份有限公司	廖唯倫技術長	
卓越技術獎	友達光電股份有限公司	全球首創1Hz低功耗LTPS筆電顯示技術	
	友達光電股份有限公司	全球首款17.3吋全捲式Micro LED顯示器	
	群創光電股份有限公司	Micro LED隱視顯示器	
傑出產品獎	面板模組類	友達光電股份有限公司	友達1.39吋 Micro LED 商品化智慧手錶
		友達光電股份有限公司	Micro LED透明顯示器整合AI智慧翻譯解決方案
		群創光電股份有限公司	27吋N3D顯示器
	材料及零組件類	達運精密工業股份有限公司	輕薄高對比綠能車用顯示器
先進設備及智慧製造類	均豪精密工業股份有限公司	次世代顯示器矩陣式膜材貼附機	
	科斯邁股份有限公司	高精度曝光機的淨零與韌性系統	
	晶彩科技股份有限公司	Micro OLED 封裝段自動光學檢測設備	



智慧顯示應用大賞

獎項	得獎廠商	得獎作品
智慧醫療獎	達運精密工業股份有限公司	Micro LED AI復健童趣機
	龍亭新技股份有限公司	病房電子床頭卡
智慧零售獎	元太科技工業股份有限公司	E Ink Marquee™綠色節能戶外廣告看板
	達運精密工業股份有限公司	Micro LED AI Runway導購關東旗
智慧移動獎	友達光電股份有限公司	無界智能儀表顯示介面
	晶達光電股份有限公司	IMRP-2435 24吋航海觸控電腦
智慧育樂獎	財團法人工業技術研究院	GAI生成式多模態智慧顯示系統
	達運精密工業股份有限公司	亞灣先進顯示示範區

跨域先進面板級科技應用趨勢論壇

顯示與非顯示應用的雙向產業升級與布局

本論壇聚焦面板產業轉型與價值重構，在深化顯示技術創新的同時，積極延伸至先進封裝PLP與矽光子光通訊CPO等高成長領域，建構跨產業技術整合新格局。面對AI驅動的算力需求與系統架構變革，從高精度製程、先進材料、異質整合到系統級封裝全面剖析關鍵技術演進，探討顯示產業如何轉化既有製造優勢，切入半導體與光通訊供應鏈核心，協助業界掌握從顯示延伸至非顯示應用的跨域升級路徑，打造具備國際競爭力的下一代產業布局與技術藍圖。



INNOLUX



AUO



Eink



COLUMBIA UNIVERSITY
IN THE CITY OF NEW YORK



APPLIED
MATERIALS
make possible



CORNING

國際Micro/Mini LED Display高峰論壇

串聯智慧座艙、XR沉浸式應用及多元場域整合

聚焦 Micro/Mini LED 與下世代顯示應用發展，議題涵蓋 Micro LED 光通訊、透明與互動顯示、Mini LED 高階背光等關鍵技術，並進一步串聯智慧座艙、XR沉浸式應用及多元場域整合，完整呈現顯示技術跨域創新的發展脈絡。透過產學研專家深度交流，深入剖析技術整合、良率提升、成本優化與規模化量產等產業化關鍵課題，協助掌握技術落地與商業應用策略，加速創新成果由研發端邁向市場應用，持續重塑顯示產業價值鏈，打造下一波顯示科技競爭優勢與產業升級動能。



XR 技術創新與產品化布局論壇

AI 驅動的智慧穿戴未來視角

本論壇聚焦 AI 驅動智慧穿戴技術，匯聚產學研專家，深入探討 XR 創新應用、光學顯示技術、系統整合挑戰與產品化布局，全面剖析光學與 AI 融合下的產業發展趨勢，描繪未來智慧穿戴設備的創新應用與設計藍圖。講師橫跨關鍵技術領域，從光學設計、感測技術、系統驗證到終端應用，分享第一線實務經驗與前瞻洞察，帶出智慧穿戴從研發到商品化的關鍵路徑，促進跨域整合與產業鏈合作契機。



電子設備先進技術系列論壇

聚焦矽光子、先進封裝與機器人，串聯高效運算與產業升級關鍵技術



矽光子CPO先進封裝之創新挑戰



矽光子生態與共封裝整合



先進封裝檢測與量測技術



3DIC封裝技術



新世代面板級封裝技術與整合應用



AI機器人驅動之全球供應鏈與國際合作



無人載具的機器視覺系統與關鍵模組



從邊緣運算到場域落地：專業服務型機器人多元應用



TGV技術如何賦能次世代AI/HPC的先進製程



封裝基板的翹曲控制與解決



AI時代的半導體技術發展與供應鏈協作

矽光子先進封裝創新與共封裝整合

匯集從AI與高效能運算晶片、光電元件、光通訊模組、先進封裝與半導體材料

本次矽光子論壇為展會焦點活動之一，深入探討矽光子與CPO技術發展趨勢及產業應用，並呈現在AI資料中心高速光互連架構中的最新應用成果，以及 Micro LED在高速光通訊的應用潛力；同時結合專區展示，帶領產業掌握下一代高速光通訊的重要方向。



AI 機器人驅動之全球供應鏈與國際合作

技術創新與商業永續深度綁定 全球供應鏈重構的關鍵穩佔先機

AI 的發展已從單純的模型與算力競爭，轉向系統層級的整合與落地能力之競逐。AI 的價值最終只取決於一件事：它能否被穩定且安全地部署；面對智慧製造、半導體等高門檻市場，建構具備內外網隔離機制的微服務化邊緣 AI 平台，已成為防禦核心資產與避免數據外洩的主流策略。此類架構不僅強化系統安全性與可控性，更是推動 AI 落地應用的關鍵基礎。在此趨勢下，企業角色亦逐步由傳統的組件代工，升級為具備系統整合能力，並進一步邁向全球生態系輸出者。



廣告媒體曝光



國內曝光

400萬+

TOTAL REACH

海外曝光

260萬+

TOTAL REACH

海內外媒體精選曝光



多元曝光內容



INNOVATION TOGETHER

EQUIPMENT

電子生產製造設備展

Electronic Equipment Exhibition

DISPLAY

智慧顯示展

Smart Display Show

SMART⁺

智慧製造展

Smart Manufacturing Taiwan

2027 展覽檔期

4/21 - 23



南港展覽館1館

TaiNEX 1, Taipei, Taiwan

徵展招募中

展昭國際企業股份有限公司

Tel: (02)2659-6000 李先生 #135 / 林小姐 #192

Fax: (02)2659-7000

Email: touch@chanchao.com.tw

台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)

Tel: (02)2729-3933 林小姐 #12 / 蕭小姐 #24 / 鄭小姐 #35

Fax: (02)2729-3950

Email: show@teeia.org.tw

